

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】令和3年5月6日(2021.5.6)

【公表番号】特表2017-503688(P2017-503688A)

【公表日】平成29年2月2日(2017.2.2)

【年通号数】公開・登録公報2017-005

【出願番号】特願2016-544402(P2016-544402)

【国際特許分類】

B 2 7 D	1/04	(2006.01)
B 2 7 M	1/02	(2006.01)
B 2 7 M	1/00	(2006.01)
B 2 7 M	3/00	(2006.01)
B 3 2 B	21/00	(2006.01)
B 3 2 B	21/12	(2006.01)

【F I】

B 2 7 D	1/04	K
B 2 7 M	1/02	
B 2 7 M	1/00	F
B 2 7 M	3/00	N
B 3 2 B	21/00	
B 3 2 B	21/12	

【誤訳訂正書】

【提出日】令和3年3月19日(2021.3.19)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0028

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0028】

少なくともある実施形態の利点は、ベニヤ要素の表面デザインが、ベニヤに浸透しているサブ層の一部によって変更ないし改变され得るということである。ベニヤ層及び/又は基板に圧力を加えることにより、サブ層の一部がベニヤの細孔、又は割目乃至穴を通過して流れ、これにより、サブ層の一部が、基板から離れたベニヤの表面において見えるようになる。このため、特にサブ層が顔料を備えている場合、ベニヤのデザインが変更される。新しいデザインが作り出される、又は、割目や節目等のベニヤの特徴が、ベニヤの表面において目に見えるサブ層により強調され得る。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0151

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0151】

実施例1：

40重量%の木材ファイバと、10重量%の酸化アルミニウム(Alodur ZWS K 180-ST)と、49.5重量%のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂(Kauramin 773)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、400g/m²の粉末混合体を、サブ層を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の

水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオーケベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、ベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填された細孔や割目を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0152

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0152】

実施例2：

40重量%の木材ファイバと、10重量%の酸化アルミニウム(Alodur ZWSK 180-ST)と、49.5重量%のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂(Kauramin 773)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、800g/m²の粉末混合体を、サブ層を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオーケベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例1の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填された割目及びより多くの細孔を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0153

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0153】

実施例3：

17.5重量%の木材ファイバと、17.5重量%の鉱物ファイバと、10重量%の酸化アルミニウム(Alodur ZWSK 180-ST)と、52.5重量%のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂(Kauramin 773)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、400g/m²の粉末混合体を、サブ層を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオーケベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例1の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填された割目及びより少ない細孔を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0154

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0154】

実施例4：

10重量%の酸化アルミニウム(Alodur ZWSK 180-ST)と、89.5重量%のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂(Kauramin 773)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、400g/m²の粉末混合体を、基板を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の水溶液と共に噴霧した。プレスプ

レート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオークベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例1の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填された割目及びより多くの細孔を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正6】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0155

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0155】

実施例5：

40.0重量%の木材ファイバと、10重量%の酸化アルミニウム(Alodur Z WSK 180-ST)と、49.5重量%の熱硬化性バインダ(Vinnapas 5010N)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、400g/m²の粉末混合体を、サブ層を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオークベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例1の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填されたより少ない細孔及び割目を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正7】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0156

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0156】

実施例6：

45重量%の水と、10重量%の酸化アルミニウム(Alodur Z WSK 180-ST)と、44.5重量%のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂(Kauraminn 773)と、0.5重量%のカーボンブラック(Printex 60)とを含む、400g/m²の液体混合体を、サブ層を形成する10.0mm厚さのHDFボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、20g/m²の離型剤(PAT-660)の水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度160で40バールにおける30秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、0.6mm厚さのオークベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、ベニヤ層中にあってサブ層の硬化した混合体で充填された細孔及び割目を含むベニヤHDFであった。

【誤訳訂正8】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- 基板(1)を準備する工程と、
- サブ層(2)を前記基板(1)の表面に設ける工程であって、前記サブ層は粉末状に設けられ、かつ前記サブ層はバインダと充填剤とを含む工程と、
- ベニヤ層(3)を前記サブ層(2)に設ける工程と、
- 前記サブ層(2)の少なくとも一部分(2a)が前記ベニヤ層(3)の細孔に浸透するよう、前記ベニヤ層(3)及び/又は前記基板(1)に圧力を加えて前記サブ層(2)

のバインダを液体状態とする工程と、

を備えたベニヤ要素(10)を製造する方法において、

前記方法は、更に、

前記サブ層(2)の前記ベニヤ層(3)の細孔への浸透を調整することによって前記ベニヤ層のデザインを決定する工程、

を備え、前記サブ層(2)の前記ベニヤ層(3)の細孔への浸透を調整する工程は、前記サブ層(2)の流圧を調整する工程を備え、前記ベニヤ層(3)及び又は前記基板(1)に圧力を加えることにより、前記サブ層(2)の少なくとも一部分(2a)が前記ベニヤ層(3)の細孔に浸透して、前記ベニヤ層(3)は強化され、前記サブ層によって含漬され、ベニヤ層(3)は改良された耐摩耗性特性を呈し、

前記サブ層(2)の前記ベニヤ層(3)の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ層(3)及び/又は前記基板(1)に圧力を加える前に、前記ベニヤ層(3)を砥粒加工する工程を備え、

前記砥粒加工工程は、前記ベニヤ層(3)及び/又は前記基板(1)に圧力を加える前に、前記ベニヤ層(3)をブラッシング加工し、これにより前記ベニヤ層(3)に前記ベニヤ層を貫通する穴(6)や割目(7)を新たに形成して、前記ベニヤ層を浸透するサブ層の抵抗を減少させる工程を備えている、

方法。

【請求項2】

圧力を加えるときに前記サブ層(2)の流圧を調整する工程は、以下のパラメータ： -
前記サブ層(2)のバインダの濃度；

- 前記サブ層(2)の水分含量；

- 前記ベニヤ層(3)及び/又は前記基板(1)に加えられる圧力；

- 前記サブ層(2)の気体圧力；

- 前記サブ層(2)の充填剤の濃度；及び

- 前記ベニヤ層(3)の厚さ；

のうちの1つ又は複数のパラメータを調整する工程を有している、

請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記サブ層(2)は、更に顔料を備えている、

請求項1または2に記載の方法。

【請求項4】

前記基板(1)は木材をベースとするボードである、

請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

前記サブ層(2)の流圧を調整する工程は、前記サブ層(2)のバインダの濃度を調整する工程を備えている、

請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

前記流圧を調整する工程は、前記サブ層(2)の水分含量を調整する工程を備えている、

請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】

前記流圧を調整する工程は、前記ベニヤ層(3)及び/又は前記基板(1)に加えられる圧力を調整する工程を備えている、

請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

前記流圧を調整する工程は、前記サブ層(2)に気体圧力を生成する工程を備えている、

請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 9】

前記気体圧力を生成する工程は、前記サブ層（2）に化学的及び／又は物理的発泡剤を含有させる工程を備えている、

請求項 8 に記載の方法。

【請求項 10】

前記サブ層（2）の前記ベニヤ層（3）の細孔への浸透を調整する工程は、前記サブ層（2）に充填剤を含有させる工程を備えている、

請求項 1 乃至 9 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 11】

前記サブ層（2）の前記ベニヤ層（3）の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ層（3）の厚さを調整する工程を備えている、

請求項 1 乃至 10 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 12】

前記サブ層（2）の前記少なくとも一部分（2a）は、前記ベニヤ層（3）の穴（6）や割目（7）に浸透する、

請求項 1 乃至 11 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 13】

前記ベニヤ層（3）は、木材ベニヤ、コークベニヤ、又はストーンベニヤを備えている、
請求項 1 乃至 12 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 14】

前記バインダは、熱硬化性バインダ又は熱可塑性バインダである、

請求項 1 3 に記載の方法。

【請求項 15】

前記サブ層（2）は耐摩耗性粒子を備えている、

請求項 1 乃至 14 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 16】

圧力を加えた後に、前記ベニヤ層はエンボスされた部分を備え、

前記サブ層（2）の一部は、エンボスされた部分において、エンボスされていない表面部分より圧縮されている、

請求項 1 乃至 15 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 17】

- 基板（1）を準備する工程と、

- サブ層（2）を前記基板（1）の表面に設ける工程であって、前記サブ層（2）はバインダと、充填剤と、顔料とを備え、かつ前記サブ層は粉末状に設けられる工程と、- ベニヤ層（3）を前記サブ層（2）に設ける工程と、

- 前記サブ層（2）の少なくとも一部分（2a）が前記ベニヤ層（3）に浸透するよう、前記ベニヤ層（3）及び／又は前記基板（1）に圧力を加えて前記サブ層（2）のバインダを液体状態とする工程と、

を備えたベニヤ要素（10）を製造する方法において、

前記方法は、更に、

前記サブ層（2）の前記ベニヤ層（3）の細孔への浸透を調整することによって前記ベニヤ層のデザインを定める工程、

を備え、前記サブ層（2）の前記ベニヤ層（3）の細孔への浸透を調整する工程は、前記サブ層（2）の流圧を調整する工程を備え、前記ベニヤ層（3）及び／又は前記基板（1）に圧力を加えることにより、前記サブ層（2）の少なくとも一部分（2a）が前記ベニヤ層（3）の細孔に浸透して、前記ベニヤ層（3）は強化され、前記サブ層によって含漬され、ベニヤ層（3）は改良された耐摩耗性特性を呈し、

前記サブ層（2）の前記ベニヤ層（3）の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ層（3）及び／又は前記基板（1）に圧力を加える前に、前記ベニヤ層（3）を砥粒加工する工程を備え、

前記砥粒加工工程は、前記ベニヤ層（3）及び／又は前記基板（1）に圧力を加える前に、前記ベニヤ層（3）をブラッシング加工し、これにより前記ベニヤ層（3）に前記ベニヤ層を貫通する穴（6）や割目（7）を新たに形成して、前記ベニヤ層を浸透するサブ層の抵抗を減少させる工程を備えている、方法。